



①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENT- UND  
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 199 15 065 A 1**

⑤1 Int. Cl.<sup>7</sup>:  
**H 01 L 23/495**  
H 01 L 23/36

②1 Aktenzeichen: 199 15 065.6  
②2 Anmeldetag: 1. 4. 1999  
④3 Offenlegungstag: 10. 2. 2000

DE 199 15 065 A 1

③0 Unionspriorität:  
P 10-217041 31. 07. 1998 JP  
  
⑦1 Anmelder:  
Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP  
  
⑦4 Vertreter:  
Meissner, Bolte & Partner, 80538 München

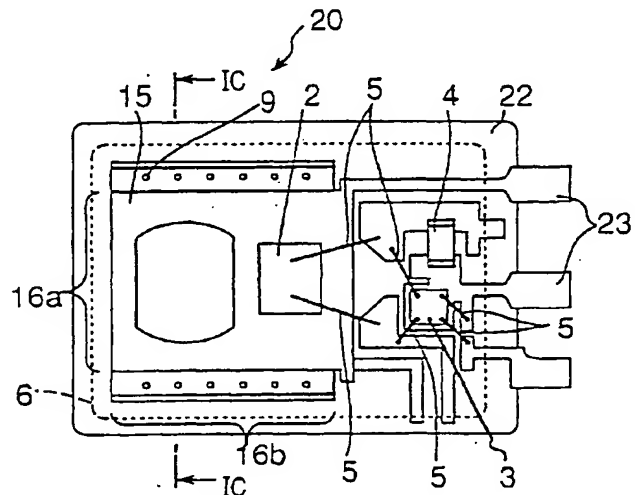
⑦2 Erfinder:  
Kawamoto, Atsunobu, Tokio/Tokyo, JP

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Halbleiterbauelement

⑤7 Die Wirkung der Ableitung von Wärme von dem Halbleiterbauelement (20) ist dadurch verbessert, daß ein flacher Trägerbereich (16a) vorgesehen ist, an dem ein Leistungsbau­element (2) angebracht ist, und daß sich der Steuerungsbauelementbereich, an dem ein Steuerungsbauelement (3) angebracht ist, kontinuierlich mit dem flachen Trägerbereich (16a) erstreckt, und daß die gegen­überliegenden Seitenränder des flachen Trägerbereichs (16a) nach oben gebogen sind, um den Verstärkungsbe­reich (16b) zu bilden, so daß die Steifigkeit der Wärmeab­leitfläche (8) an der Rückseite des Bereichs des Trägers (15), an dem das Leistungsbau­element (2) angebracht ist, erhöht ist und die Kontaktfläche der externen Wärmesen­ke (22) und der Wärmeableitfläche (8) vergrößert ist.



DE 199 15 065 A 1

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement, das mit einem Leistungsbaulement versehen ist, und insbesondere ein Halbleiterbauelement, das einen Träger hat, der mit einem daran angebrachten Leistungsbaulement versehen ist, das auf einer externen Wärmesenke in Kontakt damit befestigt ist.

Zunächst wird nachstehend ein bekanntes Halbleiterbauelement beschrieben, das mit einem Leistungsbaulement versehen ist. Ein bekanntes Halbleiterbauelement 30 hat einen Leistungsbaulementchip 2, einen monolithischen Steuerungs-IC-Chip 3 und einen Widerstandschip 4, die auf einer Chipbefestigungsfläche eines Trägers 31 mit flacher Plattenkonstruktion angebracht sind, und ist als Ganzes mit einem Formkunststoff 32 so geformt, daß eine Rückfläche 8 (nachstehend als Wärmeableitfläche bezeichnet) der Chipbefestigungsfläche des Trägers 31 freiliegt, wie die Fig. 6A und 6B zeigen. Die Wärmeableitfläche 8 wird ferner mit einer (nicht gezeigten) externen Wärmesenke in Kontakt gebracht und in dem Halbleiterbauelement 30 daran befestigt. Infolgedessen leitet die externe Wärmesenke von dem Halbleiterbauelement 30 erzeugte Wärme über die Wärmeableitfläche 8 in die Atmosphäre ab. Die drei Chips 2, 3, 4 sind durch Bonddrähte 5 miteinander verbunden, so daß eine Schaltung gebildet ist, wobei der Steuerungs-IC-Chip 3 den Leistungsbaulementchip 2 steuert.

Der Träger 31 ist aufgrund der Konstruktion in Form eines flachen Flächenkörpers nicht ausreichend steif und neigt dazu, sich zu verformen, was unter dem Einfluß von Spannungen des Formkunststoffs 32, die beim Einsiegeln des Leistungsbaulements 2 erzeugt werden, zu einer verzogenen oder verworfenen Wärmeableitfläche 8 führt. Dies bewirkt, daß zwischen der externen Wärmesenke und der Wärmeableitfläche 8 ein Zwischenraum gebildet wird, was zu dem Problem führt, daß von dem Halbleiterbauelement 30 erzeugte Wärme nicht ausreichend abgeleitet werden kann.

Das Halbleiterbauelement 30 weist ferner das Problem auf, daß es wegen der Konstruktion des Trägers 31 in Form eines flachen Flächenkörpers für den Formkunststoff 32 schwierig ist, einen engen Kontakt mit dem Träger herzustellen, so daß das Halbleiterbauelement eine geringe Zuverlässigkeit hat.

Die Erfindung soll die oben beschriebenen Probleme lösen, und Aufgabe der Erfindung ist es, ein Halbleiterbauelement anzugeben, das imstande ist, Wärme mit Hilfe einer externen Wärmesenke über einen Träger wirksam abzuleiten, und ein Halbleiterbauelement hoher Zuverlässigkeit anzugeben, die durch einen zufriedenstellend engen Kontakt zwischen dem Träger und einem Formkunststoff gewährleistet ist.

Zur Lösung der vorstehenden Aufgabe hat ein erstes Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung einen Träger erhöhter Steifigkeit, so daß ein Verwerfen oder Verziehen einer Wärmeableitfläche verhindert wird. Dabei weist das erste Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung ein Leistungsbaulement und ein Steuerungsbaulement auf, das das Leistungsbaulement steuert, wobei beide auf einer Baulement-Befestigungsfläche des Trägers angebracht und mit einem Formkunststoff eingesiegelt sind, so daß die Wärmeableitfläche an der Rückseite davon freiliegt, wobei die Wärmeableitfläche auf der externen Wärmesenke in Kontakt damit befestigt ist.

Die Befestigungsfläche des Trägers hat einen flachen Trägerbereich, auf dem das Leistungsbaulement angebracht ist, und einen Steuerungsbaulementbereich, der sich kontinuierlich mit dem flachen Trägerbereich erstreckt, wobei das Steuerungsbaulement darauf angebracht ist, während

gegenüberliegende Seitenränder des flachen Trägerbereichs nach oben gebogen sind, um einen Verstärkungsbereich zu bilden und die Steifigkeit der Wärmeableitfläche zu erhöhen.

Das erste Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung hat bevorzugt dort, wo der Formkunststoff in den Verstärkungsbereich eindringt, Durchgangslöcher oder Ausschnitte, so daß der Träger und der Formkunststoff fester miteinander verbunden sind.

Zur Lösung der vorstehenden Aufgabe ist bei einem zweiten Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung der Formkunststoffbereich in eine Vielzahl von Bereichen geringerer Größe unterteilt, so daß die durch den Formkunststoff verursachten Spannungen verringert und eine Verformung der Wärmeableitfläche verhindert wird. Dabei weist das zweite Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung ein Leistungsbaulement und ein Steuerungsbaulement auf, das das Leistungsbaulement steuert, wobei beide auf einer Baulement-Befestigungsfläche des Trägers angebracht und mit einem Formkunststoff eingesiegelt sind, so daß eine Wärmeableitfläche an der Rückseite davon freiliegt, wobei die Wärmeableitfläche auf der externen Wärmesenke in Kontakt damit befestigt ist.

Die Befestigungsfläche des Trägers hat einen flachen Trägerbereich, auf dem das Leistungsbaulement angebracht ist, und einen Steuerungsbaulementbereich, der sich kontinuierlich mit dem flachen Trägerbereich erstreckt, wobei das Steuerungsbaulement darauf angebracht ist, während der Leistungsbaulement-Formbereich, in dem das Leistungsbaulement auf dem flachen Trägerbereich eingesiegelt ist, und der Steuerungsbaulement-Formbereich, in dem das Steuerungsbaulement darauf eingesiegelt ist, voneinander getrennt sind.

Bei dem zweiten Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung sind bevorzugt gegenüberliegende Seitenränder des flachen Trägerbereichs, auf dem das Leistungsbaulement angebracht ist, von dem Träger nach oben gebogen sind, um Verstärkungsbereiche zu bilden und die Steifigkeit der Wärmeableitfläche zu erhöhen, so daß eine Verformung der Wärmeableitfläche zuverlässiger verhindert wird.

Bei dem zweiten Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung sind ferner bevorzugt dort, wo der Formkunststoff in den Verstärkungsbereich eindringt, Durchgangslöcher oder Ausschnitte in den Verstärkungsbereichen vorgesehen sind, so daß der Träger und der Formkunststoff fester miteinander verbunden sind.

Bei dem zweiten Halbleiterbauelement gemäß der Erfindung wird außerdem dadurch, daß ein gekrümmter Leiterbereich vorgesehen ist, der sich zu dem Steuerungsbaulementbereich und dem flachen Trägerbereich fortsetzt und zwischen dem Steuerungsbaulement-Formbereich und dem Leistungsbaulement-Formbereich freiliegt, eine äußere Kraft von dem gekrümmten Leiterbereich absorbiert, so daß ein Bruch des Leiterbereichs verhindert wird und die Zuverlässigkeit des Halbleiterbauelements verbessert werden kann.

Die Erfindung wird nachstehend, auch hinsichtlich weiterer Merkmale und Vorteile, anhand der Beschreibung von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Die Zeichnungen zeigen in:

Fig. 1A eine Draufsicht auf ein Halbleiterbauelement gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 1B eine Seitenansicht des Halbleiterbauelements gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 1C eine Querschnittsansicht entlang der Linie IC-IC in Fig. 1A;

Fig. 2A eine Draufsicht auf eine erste Abwandlung des

Halbleiterbauelements gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 2B eine Seitenansicht der ersten Abwandlung des Halbleiterbauelements gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3A eine Draufsicht auf eine zweite Abwandlung des Halbleiterbauelements gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 3B eine Seitenansicht der zweiten Abwandlung des Halbleiterbauelements gemäß der ersten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 4A eine Draufsicht auf ein Halbleiterbauelement gemäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 4B eine Seitenansicht des Halbleiterbauelements gemäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 5A eine Draufsicht auf eine Abwandlung des Halbleiterbauelements gemäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 5B eine Seitenansicht der Abwandlung des Halbleiterbauelements gemäß der zweiten Ausführungsform der Erfindung;

Fig. 6A eine Draufsicht auf ein bekanntes Halbleiterbauelement;

Fig. 6B eine Seitenansicht des bekannten Halbleiterbauelements.

Bevorzugte Ausführungsformen des Halbleiterbauelements werden nachstehend beschrieben.

#### Ausführungsform 1

Ein Halbleiterbauelement 20 gemäß der ersten Ausführungsform hat einen Formbereich 6, der an einer externen Wärmesenke 22 befestigt ist, wie Fig. 1A zeigt. Der Formbereich 6 weist folgendes auf: einen Leistungsbauelementchip 2, einen Steuerungsbauelementchip 3 und einen Widerstandschip 4, die auf einem Träger 15 versiegelt sind, und der Träger 15 hat einen Bereich, in dem der Leistungsbauelementchip 2 an der Bauelement-Befestigungsfläche angebracht ist, und einen Bereich, in dem der Steuerungsbauelementchip 3 und der Widerstandschip 4 angebracht sind.

Der Leiterraum oder Träger 15 erstreckt sich zu der Außenseite des Formbereichs 6, wobei ein Ende davon einen externen Anschluß 23 bildet. Wie Fig. 1B zeigt, weist der Formbereich 6 die drei Chips 2, 3, 4 auf, die gemeinsam mit dem Formkunststoff eingesiegelt sind, während ein Bereich 8 (nachstehend als Wärmeableitfläche bezeichnet) an der Rückseite des Bereichs freiliegt, wo der Leistungsbauelementchip 2 auf der Bauelement-Befestigungsfläche angebracht ist, während der Bereich des Trägers 15 dort, wo der Steuerungsbauelementchip 2 und der Widerstandschip 4 angebracht sind, vollständig von dem Formkunststoff bedeckt ist.

Der Formbereich 6 ist ferner an der externen Wärmesenke 22 befestigt, wobei die Wärmeableitfläche in Kontakt mit der externen Wärmesenke 22 gebracht ist. Die drei Chips 2, 3, 4 sind durch Bonddrähte 5 miteinander verbunden, so daß eine Schaltung gebildet ist, in der der Steuerungsbauelementchip 4 den Leistungsbauelementchip 2 steuert.

Andererseits ist der Leistungsbauelementchip 2 auf dem Leistungsbauelementbereich 16a angebracht, der ein flacher Bereich der Bauelement-Befestigungsfläche des Trägers 15 ist, und Trägerwände 16b sind vorgesehen, die sich entlang von Seitenrändern des Trägers 15 an beiden Seiten des Leistungsbauelementbereichs 16a erstrecken, so daß der Leistungsbauelementbereich 16a verstärkt wird.

Wie Fig. 1C zeigt, erstrecken sich dabei die Trägerwände 16b von dem Leistungsbauelementbereich 16a nach oben zu

der Außenseite, und eine Vielzahl von Durchgangslöchern 9 ist in den Seitenflächen der Trägerwände 16b vorgesehen, wie die Fig. 1A und 1B zeigen. Bei dieser Ausführungsform haben die Durchgangslöcher 9 einen Durchmesser von 0,6 mm und sind in Abständen von 2 mm angeordnet.

Wie oben beschrieben, wird, da die Steifigkeit der Wärmeableitfläche 8 des Trägers 15 durch das Vorsehen der Trägerwände 16b an dem Träger 15 erhöht ist, eine Verformung des Trägers 15 aufgrund von Spannungen, die beim Einsiegeln oder Versiegeln der Chips 2, 3, 4 erzeugt werden, vermieden, so daß ein Verwerfen oder Verziehen der Wärmeableitfläche 8 verhindert wird. Infolgedessen wird die Wärmeableitfläche 8 im flachen Zustand und ohne einen Zwischenraum in engem Kontakt mit der externen Wärmesenke 22 gehalten, so daß die von dem Leistungsbauelement 2 erzeugte Wärme wirksam abgeleitet werden kann.

Da der Formkunststoff in die in den Trägerwänden 16b geformten Durchgangslöcher 9 eindringt, sind der Formkunststoff und der Träger 15 fester miteinander verbunden, so daß die Zuverlässigkeit des Halbleiterbauelements 20 verbessert wird.

Nachstehend wird das Halbleiterbauelement 20a gemäß einer ersten Abwandlung des Halbleiterbauelements 20 beschrieben. Wie Fig. 2 zeigt, hat das Halbleiterbauelement 20a Ausschnitte 10a, die in den Trägerwänden 16b so ausgebildet sind, daß sie sich zu der Unterseite der Trägerwände 16b hin öffnen. Bei dieser Ausführungsform haben die Ausschnitte 10a eine Abmessung von 1 mm an einer Seite und sind in Abständen von 3 mm angeordnet. Das Halbleiterbauelement 20a ist mit Ausnahme der Ausschnitte 10a das gleiche wie das Halbleiterbauelement 20 der ersten Ausführungsform.

Da der Formkunststoff in die in den Trägerwänden 16b gebildeten Ausschnitte 10a eindringt, sind der Formkunststoff und der Träger 15 fester miteinander verbunden, so daß die Zuverlässigkeit des Halbleiterbauelements 20a verbessert wird.

Nachstehend wird ein Halbleiterbauelement 20b gemäß der zweiten Abwandlung des Halbleiterbauelements 20 beschrieben. Wie Fig. 3 zeigt, hat das Halbleiterbauelement 20b Ausschnitte 10b, die in den Trägerwänden 16b so ausgebildet sind, daß sie sich zum oberen Ende der Trägerwände 16b hin öffnen. Bei dieser Ausführungsform haben die Ausschnitte 10b Abmessungen von 1 mm an einer Seite und sind in Abständen von 3 mm angeordnet. Das Halbleiterbauelement 20b ist das gleiche wie das Halbleiterbauelement 20 der ersten Ausführungsform, mit der Ausnahme, daß die Ausschnitte 10b vorgesehen sind.

Da bei der oben beschriebenen Konstruktion der Formkunststoff in die in den Trägerwänden 16b gebildeten Ausschnitte 10b eindringt, sind der Formkunststoff und der Träger 15 fester miteinander verbunden, so daß die Zuverlässigkeit des Halbleiterbauelements 20b verbessert wird.

Obwohl sich bei der oben beschriebenen ersten Ausführungsform die Trägerwände 16b von dem flachen Trägerbereich schräg nach oben erstrecken, ist die Erfindung nicht auf eine Konstruktion beschränkt, bei der sich die Trägerwände von dem flachen Trägerbereich schräg nach oben erstrecken; die Trägerwände können sich von dem flachen Bereich auch vertikal nach oben erstrecken.

#### Ausführungsform 2

Nachstehend wird ein Halbleiterbauelement 21 gemäß der zweiten Ausführungsform beschrieben. Wie Fig. 4A zeigt, hat das Halbleiterbauelement 21 einen Leistungsbauelement-Formbereich 6a und einen Steuerungsbauelement-Formbereich 6b, wobei der Leistungsbauelement-Formbe-

reich 6a an einer externen Wärmesenke 22 befestigt ist. Der Leistungsbaulement-Formbereich 6a dient dem Einsiegeln des Leistungsbaulementchips 2, und der Steuerungsbaulement-Formbereich 6b dient dem getrennten Versiegeln des Widerstandschip 4 und des Steuerungsbaulementchips 3 auf dem Träger 15a. Ähnlich wie bei der ersten Ausführungsform hat der Träger 15a einen Bereich, in dem der Leistungsbaulementchip 2 an der Baulement-Befestigungsfläche angebracht ist, und einen Bereich, in dem der Steuerungsbaulementchip 3 und der Widerstandschip 4 angebracht sind. Ein Ende des Trägers 15a dient als ein externer Anschluß 23.

Wie Fig. 4B zeigt, weist dabei der Leistungsbaulement-Formbereich 6a den Leistungsbaulementchip 2 auf, der mit einem Formkunststoff versiegelt ist, während ein Bereich 8 (nachstehend als Wärmeableitfläche bezeichnet) an der Rückseite des Bereichs freiliegt, wo der Leistungsbaulementchip 2 auf der Baulement-Befestigungsfläche angebracht ist. Der Steuerungsbaulement-Formbereich 6b weist den Steuerungsbaulementchip 3 und den Widerstandschip 4 darin versiegelt auf, so daß ein Bereich, in dem beide Chips 3, 4 daran angebracht sind, vollständig mit dem Formkunststoff bedeckt ist.

Andererseits liegt ein Teil 17 (nachstehend als freiliegender Leiterbereich bezeichnet) des Trägers 15a zwischen dem Leistungsbaulement-Formbereich 6a und dem Steuerungsbaulement-Formbereich 6b frei. Die drei Chips 2, 3, 4 sind durch die Bonddrähte 5 miteinander verbunden, so daß eine Schaltung gebildet ist, in der der Steuerungsbaulementchip 3 den Leistungsbaulementchip 2 steuert.

Da der Formbereich in zwei Bereiche unterteilt ist, haben der Leistungsbaulement-Formbereich 6a und der Steuerungsbaulement-Formbereich 6b geringere Größe. Diese Konstruktion verringert die Spannungen, die beim Einsiegeln des Leistungsbaulementchips 2 auf dem Träger 15a erzeugt werden, und verhindert daher eine Verformung der Wärmeableitfläche 8, so daß die Wärmeableitfläche in einem flachen Zustand gehalten werden kann.

Trägerwände, die denen der ersten Ausführungsform ähnlich sind, können ebenfalls an beiden Seiten des Leistungsbaulementbereichs vorgesehen sein, wo der Leistungsbaulementchip auf der Baulement-Befestigungsfläche des Trägers 15a angebracht ist. Diese Konstruktion erhöht die Steifigkeit der Wärmeableitfläche, so daß die Wärmeableitfläche zuverlässiger im flachen Zustand gehalten wird.

Es können ferner, ähnlich wie bei der ersten Ausführungsform, Durchgangslöcher oder Ausschnitte in den Trägerwänden vorgesehen sein, so daß der Formkunststoff und der Träger fester miteinander verbunden sind.

Nachstehend wird eine Abwandlung des Halbleiterbauelements 21a gemäß der zweiten Ausführungsform unter Bezugnahme auf Fig. 5 beschrieben. Das Halbleiterbauelement 21a dieser Abwandlung ist das gleiche wie das Halbleiterbauelement 21, wobei jedoch eine U-förmige Krümmung 17a in dem freiliegenden Leiterbereich 17 vorgesehen ist.

Durch das Vorsehen der U-förmigen Krümmung 17a in dem freiliegenden Leiterbereich 17 wird eine externe Kraft, die auf den externen Anschluß 23 übertragen wird, wenn eine zusätzliche Komponente an den externen Anschluß 23 des Halbleiterbauelements 21a angeschlossen wird, in der U-förmigen Krümmung 17a absorbiert, so daß ein Bruch des freiliegenden Leiterbereichs 17 verhindert wird.

Da bei dem ersten Halbleiterbauelement die Trägerwände an beiden Seiten des flachen Bereichs des Trägers vorgesehen sind, wo der Leistungsbaulementchip angebracht ist, so daß die Steifigkeit der Wärmeableitfläche des Trägers erhöht wird, wird eine Verformung der Wärmeableitfläche des

Trägers aufgrund der von dem Formkunststoff verursachten Spannungen verhindert.

Da bei dem ersten Halbleiterbauelement die Durchgangslöcher oder die Ausschnitte in den Trägerwänden vorgesehen sind, dringt der Formkunststoff in die Durchgangslöcher oder die Ausschnitte ein, so daß die Zuverlässigkeit des Halbleiterbauelements verbessert wird.

Da bei dem zweiten Halbleiterbauelement der Leistungsbaulement-Formbereich, in dem der Leistungsbaulementchip versiegelt ist, und der Steuerungsbaulement-Formbereich, in dem der Steuerungsbaulementchip versiegelt ist, getrennt vorgesehen sind, hat jeder Formbereich geringere Größe, so daß die von dem Formkunststoff erzeugten Spannungen verringert und eine Verformung des Trägers verhindert wird.

Da bei dem zweiten Halbleiterbauelement die Trägerwände an beiden Seiten des flachen Bereichs des Trägers vorgesehen sind, wo der Leistungsbaulementchip angebracht ist, so daß die Steifigkeit der Wärmeableitfläche des Trägers erhöht ist, wird eine Verformung der Wärmeableitfläche des Trägers aufgrund der von dem Formkunststoff verursachten Spannungen zuverlässiger verhindert.

Da bei dem zweiten Halbleiterbauelement die Durchgangslöcher oder die Ausschnitte in den Trägerwänden vorgesehen sind, dringt der Formkunststoff in die Durchgangslöcher oder die Ausschnitte ein, so daß die Zuverlässigkeit des Halbleiterbauelements verbessert wird.

Da bei dem zweiten Halbleiterbauelement die Krümmung in dem freiliegenden Leiterbereich vorgesehen ist, der zwischen dem Leistungsbaulement-Formbereich und dem Steuerungsbaulement-Formbereich gebildet ist, wird ein Bruch des freiliegenden Leiterbereichs durch eine äußere Kraft verhindert.

#### Patentansprüche

1. Halbleiterbauelement mit einem Leistungsbaulement (2) und einem Steuerungsbaulementchip, welches das Leistungsbaulement (2) steuert, wobei beide auf einer Baulement-Befestigungsfläche eines Trägers (15) angebracht sind, der eine Wärmeableitfläche (8) hat, die mit einer externen Wärmesenke (22) an der Rückseite davon in Kontakt ist, und mit einem Formkunststoff versiegelt sind, wobei die Baulement-Befestigungsfläche des Trägers (15) einen flachen Trägerbereich, auf dem das Leistungsbaulement (2) angebracht ist, und einen Steuerungsbaulementbereich hat, der sich kontinuierlich mit dem flachen Trägerbereich erstreckt, wobei das Steuerungsbaulement (3) darauf angebracht ist, und wobei gegenüberliegende Seitenränder des flachen Trägerbereichs nach oben gebogen sind, um einen Verstärkungsbereich (16b) zu bilden.
2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Durchgangslöcher (9) oder Ausschnitte (10a, 10b) in den Verstärkungsbereichen (16b) vorgesehen sind, in die der Formkunststoff eindringt.
3. Halbleiterbauelement, das ein Leistungsbaulement (2) und ein Steuerungsbaulement (3) hat, welches das Leistungsbaulement (2) steuert, wobei beide auf einer Baulement-Befestigungsfläche eines Trägers (15a) angebracht sind, der eine Wärmeableitfläche (8) hat, die mit einer externen Wärmesenke (22) an der Rückseite davon in Kontakt ist, und mit einem Formkunststoff versiegelt sind, wobei die Befestigungsfläche des Trägers (15a) einen flachen Trägerbereich, auf dem das Leistungsbaulement (2) angebracht ist, und einen Steuerungsbaulementbereich hat, der sich kontinuierlich mit dem flachen Trägerbereich erstreckt, wobei das Steuerungsbaulement (3) darauf angebracht ist, und wobei gegenüberliegende Seitenränder des flachen Trägerbereichs nach oben gebogen sind, um einen Verstärkungsbereich (16b) zu bilden.

mentbereich hat, der sich kontinuierlich mit dem flachen Trägerbereich erstreckt, wobei das Steuerungsbau-  
bauelement (3) darauf angebracht ist, und  
wobei ein Leistungsbau-  
element-Formbereich (6a), in  
dem der Leistungsbau-  
elementchip (2) auf dem flachen 5  
Trägerbereich versiegelt ist, und ein Steuerungsbau-  
element-Formbereich (6b), in dem der Steuerungsbau-  
elementchip (3) darauf versiegelt ist, voneinander ge-  
trennt sind.

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 3, dadurch ge- 10  
kennzeichnet, daß gegenüberliegende Seitenränder des  
flachen Trägerbereichs, auf dem das Leistungsbau-  
element (2) angebracht ist, von dem Träger (15a) nach  
oben gebogen sind, um Verstärkungsbereiche (16b) zu  
bilden. 15

5. Halbleiterbauelement nach Anspruch 4, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß Durchgangslöcher (9) oder Aus-  
schnitte (10a, 10b) in den Verstärkungsbereichen (16b)  
vorgesehen sind, in die der Formkunststoff eindringt.

6. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 3 20  
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß ein gekrümmter  
Leiterbereich (17a) vorgesehen ist, der sich zu dem  
Steuerungsbau-  
elementbereich und dem flachen Träger-  
bereich fortsetzt und zwischen dem Steuerungsbau-  
element-Formbereich (6b) und dem Leistungsbau-  
element-Formbereich (6a) freiliegt. 25

---

Hierzu 6 Seite(n) Zeichnungen

---

30

35

40

45

50

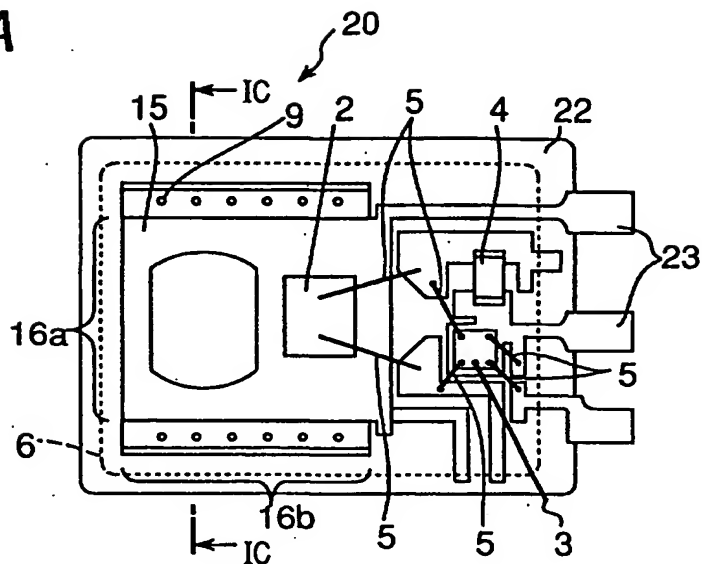
55

60

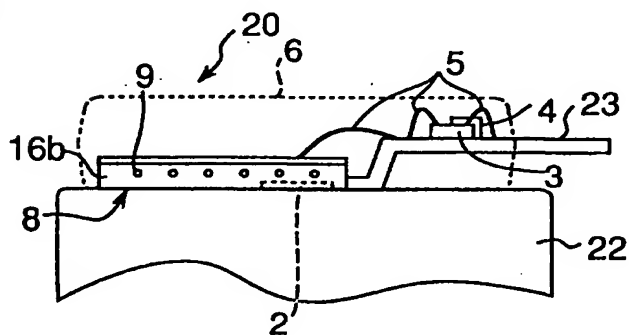
65

- Leerseite -

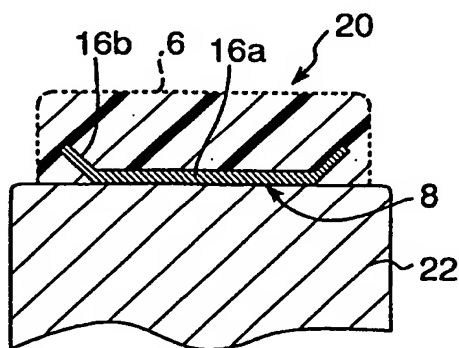
*Fig. 1A*



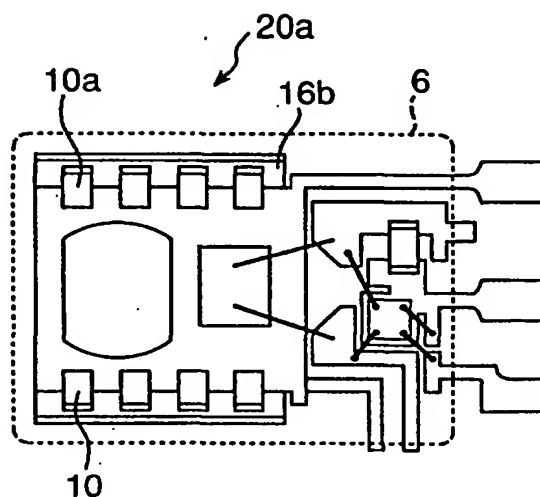
*Fig. 1B*



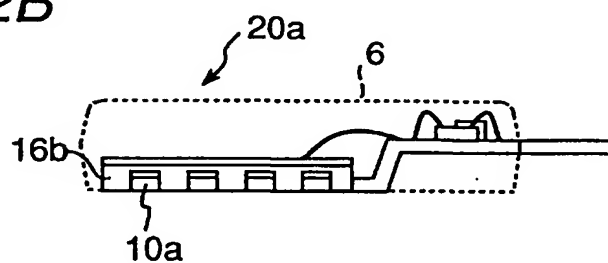
*Fig. 1C*



*Fig.2A*

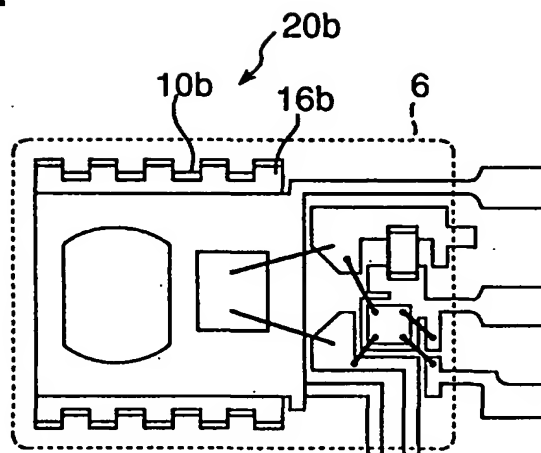


*Fig.2B*

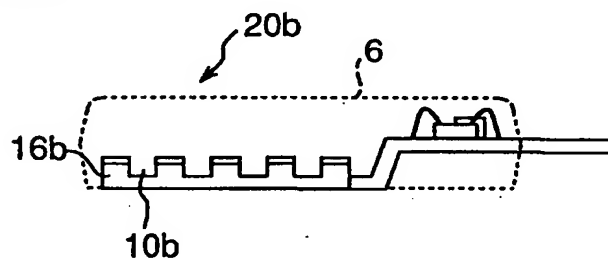




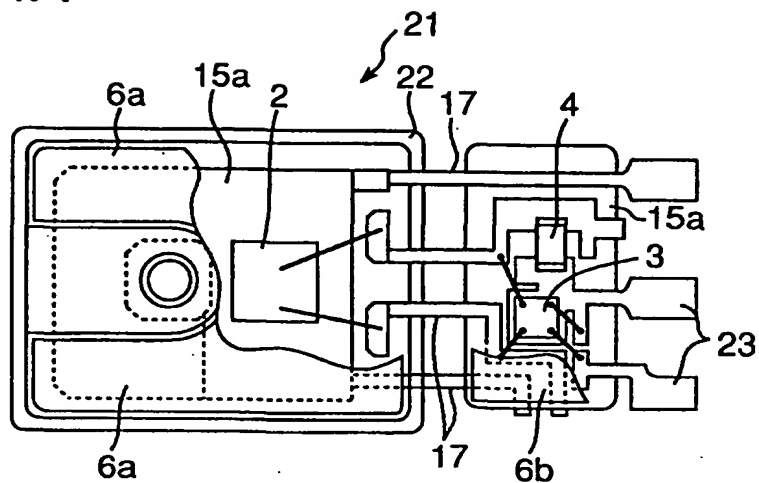
*Fig.3A*



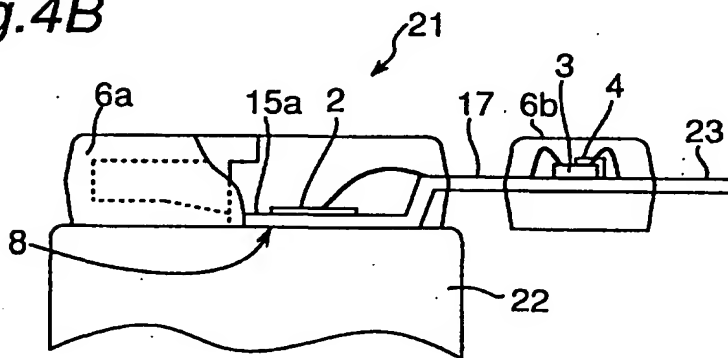
*Fig.3B*



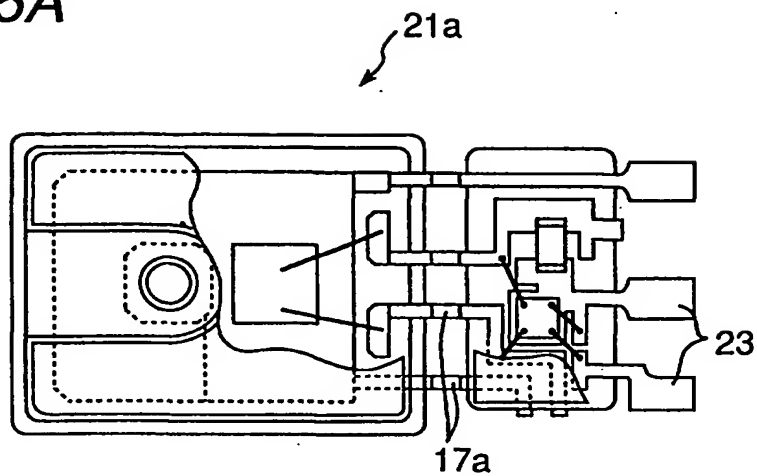
*Fig.4A*



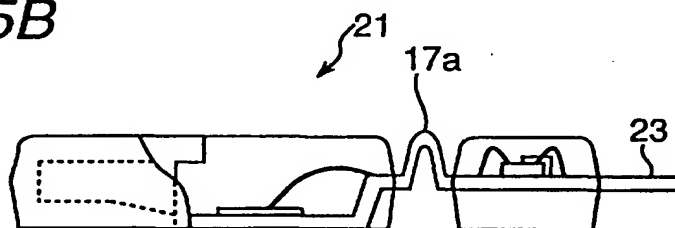
*Fig.4B*



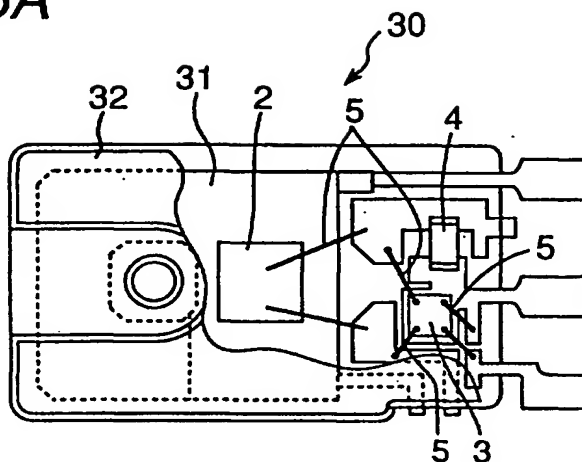
*Fig.5A*



*Fig.5B*



*Fig.6A*



*Fig.6B*

